

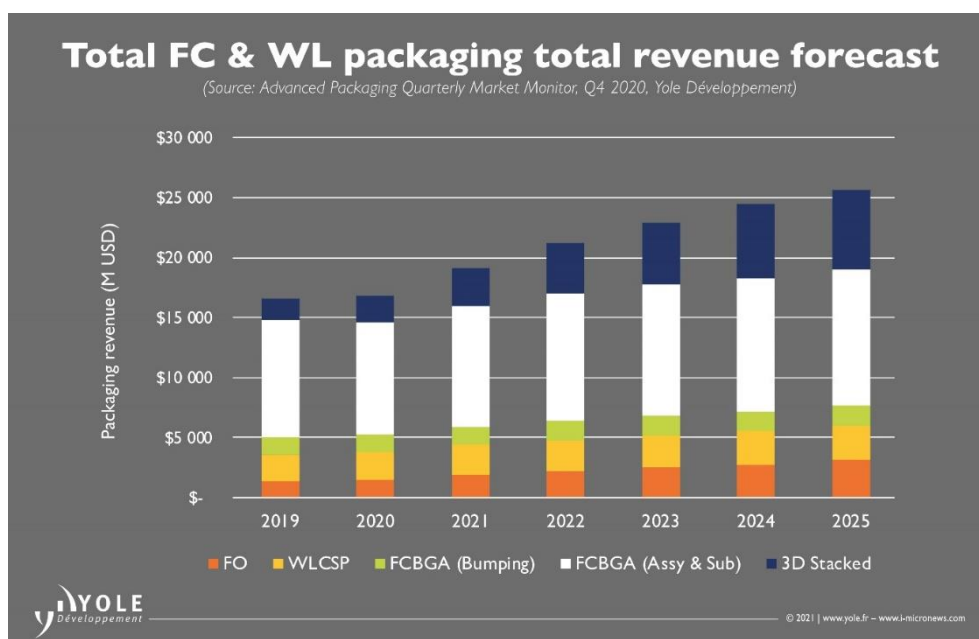
先进封装：助力半导体企业大展拳脚的关键技术

概要：

- 市场预测：先进封装市场预计 2019-2025 年复合年增长率为 6.6%，2025 年将达到 420 亿美元。其中 2.5D/3D 堆叠 IC、ED 和 FO 是增长最快的技术平台，复合年增长率分别为 21%、18%和 16%。
- 供应链：台积电、英特尔、三星、安靠、日月光都活跃于先进封装市场。
- COVID-19 的影响：由于新冠疫情爆发，预计 2020 年先进封装同比下降 6.8%，但该市场将在 2021 年反弹。
- [SYNAPS 2021](#) - 先进封装&系统集成技术研讨会将于 2021 年 5 月 18 日-20 日举办。

“龙头企业必须迅速行动，发挥优势，创新并竞争。先进封装无疑是关键，”
[Yole Développement](#) 先进封装团队主分析师 Favier Shoo 表示。

2019 年至 2025 年，先进封装市场复合年增长率 6.6%，市场营收在此期间将增加一倍以上。Yole 的先进封装团队预测，到 2025 年该市场营收将突破 420 亿美元。这几乎是传统封装市场预期增长率（2.2%）的三倍。



在此动态环境下，Yole 和华进半导体宣布将于 2021 年 5 月 18 日-20 日联合举办 SYNAPS 技术研讨会。该研讨会已连续举办 7 年，每次参会人员超 200 人。

作为一场线上研讨会，[SYNAPS](#) 为业内龙头企业提供了分享愿景、评估新技术、发现商机的独一无二的平台。[SYNAPS](#) 的目标是传递先进封装市场现状，助力企业迎接新的机遇和挑战。

事实上，Yole 深入调研了具有颠覆性的先进封装技术和相关市场，总结了最新的创新趋势，并强调了商机。相关内容可参考以下报告：

- [《先进封装市场现状及动态（2020 版）》](#) 遵循行业演变，分析了市场和领先先进封装公司的关键战略……
- [《先进封装市场季度监测》](#) 于每季度末发布，及时传递市场动态以及关键企业的战略

先进封装行业现状如何？将如何演变？哪些平台主导着市场？潜在应用有哪些？新冠肺炎疫情的影响是什么？Yole 紧跟行业和技术发展，欢迎参加 YOLE 和华进半导体共同举办的 [SYNAPS 2021](#)，获得解答。

2015-2025 technology roadmap in wafer: From nano-scale to micro-scale

(Source: Status of the Advanced Packaging Industry report, Yole Développement, 2020)



Industry is looking into the growing importance of functional roadmap Advanced Packaging is essential to bridge the scale-gap between die and PCB

*Minimum dimension

先进封装市场正在吸引半导体供应链各个层面的大公司。台积电、英特尔、三星、安靠、日月光等都活跃于该市场，精准定位，把握了业务价值。先进封装技术已经成为半导体创新的关键，赋能行业探索和创新，并填补芯片和 PCB 之间的差距。

受新冠肺炎影响，预计 2020 年先进封装市场同比下降 6.8%。Yole 半导体、存储&计算事业部总监 Emilie Jolivet 表示，“但是，我们非常乐观，坚信该市场将在 2021 年反弹，同比增长约 14%。”

Yole Korea 封装、组装&基板事业部总监&首席分析师 Santosh Kumar 解释：“预计 2.5D/3D TSV IC、ED 和 FO 市场营收增长最快，市场份额分别为 21.3%、18%和 16%。由 COVID-19 导致的新用户行为，从数字娱乐、远程工作到数字业务规模的激增，数据驱动的产品运用显然正在加速。”

例如，移动、网络和汽车领域的 FO，人工智能、机器学习、高性能计算、数据中心、CIS 和 3D NAND 领域中的 3D 堆叠，汽车、移动和基站领域的 ED 等。从营收细分来看，2019 年移动和消费市场占先进封装总营收的 85%，Yole 预计到 2025 年，该市场复合年增长率有望实现 5.5%，占先进封装市场总营收的 80%。与此同时，电信和基础设施是营收增长最快的细分市场，约占先进封装市场份额的 13%。Yole 的分析师预测，到 2025 年，该市场份额将从 2019 年的 10%增加到 14%。同时，从营收来看，汽车及运输细分市场将以 10.6%（2019-2025 年）的复合年增长率增长，2025 年实现 19 亿美元左右。

不容置疑，先进封装已然成为创新的核心。尤其对半导体行业而言，大趋势带来了新的挑战。来自世界各地的领先的先进封装公司将在 2021 年的 SYNAPS 大会上交流他们的愿景和展望。

华进半导体总经理肖克表示：“毫无疑问新冠疫情向世界提出了挑战,但它也对半导体行业产生了积极的影响。疫情改变了生活和工作方式,比如居家办公和自动化投资成为趋势,这势必会推动计算、微处理器和内存等市场需求。在此背景下,2021 年半导体行业将充满机遇。华进半导体和



YOLE 希望通过举办 SYNAPS，促进先进封装行业的国际交流和全球合作，促进全球半导体行业的发展。欢迎您加入 SYNAPS 2021，共同开拓中国市场！”

[《先进封装市场现状及动态（2020 版）》](#)和 [《先进封装市场季度监测》](#)都对先进封装领域进行了深入的探索。与此同时，[SYNAPS](#)是获得最新市场动态和技术发展的专业平台。如需了解行业相关讯息，请通过 i-microonews.com关注我们。

Press contacts:

Sandrine Leroy, Director, Public Relations, leroy@yole.fr

Marion Barrier, Assistant, Public Relations, marion.barrier@yole.fr

Le Quartz, 75 Cours Emile Zola – 69100 Villeurbanne – Lyon – France – +33472830189

www.yole.fr - www.i-micronews.com – [LinkedIn](#) – [Twitter](#)

###